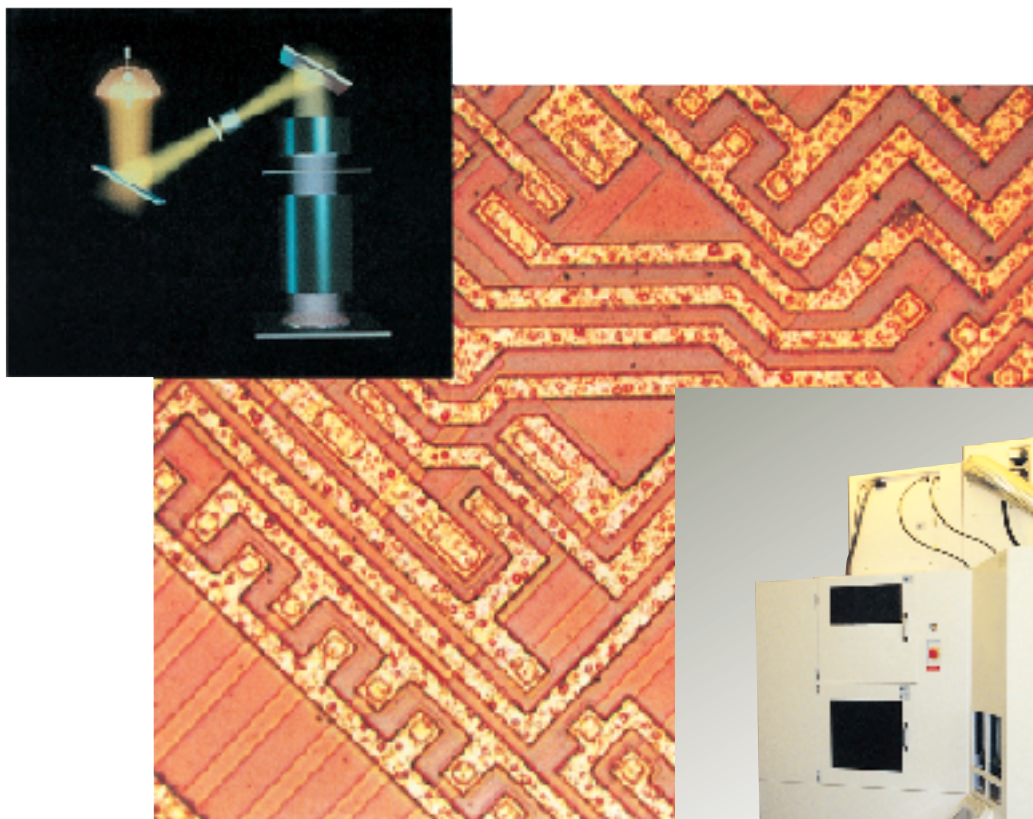


マイクロマシン用 等倍プロジェクションアライナ



ウシオー一括投影露光装置

UX-2003SM-AGG01

□20mm~φ4インチウェハー一括 7 μ mL/Sのスペックを持つ、等倍投影露光光学系を搭載。マイクロマシン用途として、深い焦点深度(±50 μ m)投影レンズを採用しているため、厚膜レジストの露光に最適です。

特長

- ・ □20mm~φ4インチウェハーまで、高精度アライメントにて一括露光可能。
- ・ 深い焦点深度。厚膜レジスト、段差基板への露光に対応。
- ・ アライメントは、マスクマーク検出後、ワークマークを観察しながらアライメントを行う、ウシオ独自のフリーズ方式。
- ・ マスクダメージレス。マスクとウェハーが非接触な投影露光方式。

用途

- ・ マイクロマシニング、各種電子部品
- ・ 半導体分野

未来は「光」でおもしろくなる

USHIO

基本仕様

型式	UX-2003SM-AGG01
露光方式	片面一括投影露光方式
対象ワーク	20mm角、 $\phi 2$ 、 $\phi 4$ インチSi
適用マスク	2、2.5、3、4、5インチ 石英製（ペリクル無し）
投影レンズ	UPL-03UX
有効露光エリア	$\phi 100$ mm
解像力	7 μ m L/S (1 μ mtポジレジストにて)
焦点深度	± 50 μ m
ランプ出力	500W、1kW超高压水銀ランプ（オプション）
露光波長	365nm、405nm、436nm
照度均一度	$\pm 5\%$ 以内(有効露光領域 $\phi 100$ mm以内)
アライメント方式	アライメントモニタ(CRT)を観察しながら行うマニュアルアライメント
ワーク搬送	手置き
装置大きさ	
外観寸法	1400mm(W)×1050mm(D)×2206mm(H)
重量	本体約1000kg ブローユニット約10kg

オプション

- ・裏面アライメント検出ユニット
ワーク裏面のアライメントマークを検出し、マスクとのアライメントを行い、ワーク表面を露光できるユニットです。
- ・露光波長選択機能
- ・サーマルチャンバ
- ・紫外線照度計



裏面アライメント検出ユニット ▶

その他

両面同時露光、自動搬送、高解像度バージョンなどは、別途ご相談ください。

・本カタログに掲載されている装置外観写真にはオプションを含む場合があります
・本カタログ掲載装置の外観・仕様等は、改良のため予告なく変更することがあります